中国AI芯片行业发展现状研究与投资前景预测报告（2026-2033年）

报告大纲

观研报告网
www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国AI芯片行业发展现状研究与投资前景预测报告（2026-2033年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：https://www.chinabaogao.com/baogao/202609/818278.html

报告价格：电子版: 8200元　纸介版：8200元　电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sales@chinabaogao.com

联 系 人 : 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，页面图表可能存在缺失；格式美观性可能有欠缺，实际报告排版规则、美观；可联系客服索取更完整的目录大纲。

二、报告目录及图表目录

AI芯片是为执行人工智能算法而设计的半导体器件，为AI模型训练与推理提供高效硬件支撑。通过架构创新与能效优化，AI芯片实现对机器学习等AI算法的快速处理，是连接AI软件与实际应用的关键硬件载体。

我国AI芯片行业相关政策

为进一步推动AI芯片行业的发展，我国陆续发布了多项政策，如2026年9月国家发展改革委等四部门发布《电子信息制造业发展“十五五”规划》，推进软硬协同和电子系统设备突破，推进RISC-V研发与产业化，支持RISC-V芯片在人工智能、嵌入式系统等领域应用。

我国AI芯片行业部分相关政策情况 发布时间 发布部门 政策名称 主要内容 2026年9月 工信部、国家发改委 电子信息制造业发展“十五五”规划 推进软硬协同和电子系统设备突破，推进RISC-V研发与产业化，支持RISC-V芯片在人工智能、嵌入式系统等领域应用。 2026年4月 国家发展改革委等四部门 关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案 推动人工智能自主可控软硬件在能源领域深度应用。加快自主智算芯片与国产深度学习框架的适配优化，推动多框架协同运行，推动能源领域大模型高效迁移技术在典型场景中的应用。持续推动能源领域人工智能软硬件技术迭代升级，提升能源领域基础设施智能化水平。 2026年3月 全国人民代表大会 中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要 壮大数字经济核心产业，发展新一代通信技术、云计算、区块链等产业，提升高端芯片、光电子器件、基础软件和工业软件等产业水平，打造具有国际竞争力的数字产业集群。推进国家人工智能创新高地建设，培育智能原生新模式新业态，建设国家人工智能应用中试基地。 2026年1月 工业和信息化部 工业互联网和人工智能融合赋能行动方案 加快技术产品创新。鼓励人工智能企业、工业互联网企业、工控企业联合推进工业通信芯片、工业传感器、工业终端、工业控制系统等智能化升级，逐步深化人形机器人应用。利用人工智能优化工业软件开发流程和模式，提升主动优化、辅助生成等能力，降低开发门槛和成本。 2025年12月 工业和信息化部等八部门 “人工智能+制造”专项行动实施意见 强化人工智能算力供给。推动智能芯片软硬协同发展，支持突破高端训练芯片、端侧推理芯片、人工智能服务器、高速互联、智算云操作系统等关键技术。 2025年8月 工业和信息化部 关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见 持续开展卫星通信关键核心技术攻关和产品研制，增强基础元器件、芯片、关键终端设备产品等供给水平，提升卫星通信技术性能，降低用户使用成本，推动我国卫星通信技术持续迭代演进。 2025年8月 国务院 关于深入实施“人工智能+”行动的意见 支持人工智能芯片攻坚创新与使能软件生态培育，加快超大规模智算集群技术突破和工程落地。 2025年8月 工业和信息化部、国家发展改革委、教育部等部门 关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见 突破关键脑机芯片。发展高通道、高速率脑信

号采集芯片，强化模数转换、通道管理和噪声抑制，增强脑信号采集放大能力。研发高性能、超低功耗脑信号处理芯片，强化并行处理能力，推动感知、计算和调节等功能的一体化集成。研发超低功耗、高速率、高可靠的通信芯片，提升脑信号传输和抗干扰能力。

2025年6月 市场监管总局、工业和信息化部 计量支撑产业新质生产力发展行动方案（2025—2030年） 面向新一代显示、通信、芯片等信息领域，聚焦未来先进信息化芯片研发、高精度时间频率服务、新型显示产品测评等方向计量测试需求，开展计量关键技术攻关。 2025年6月 国家发展改革委办公厅等 关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知 加快高压碳化硅模块、主控芯片等核心器件国产化替代，推动涵盖零部件、系统集成、运营服务的充电产业链整体升级。 2025年6月 工业和信息化部 关于制造业计量创新发展的意见 加强计量器具的中试及应用验证，提高自主计量器具的可靠性、稳定性、安全性和适用性，提升基于安全可靠测评的芯片、操作系统、数据库的数字技术产品集成应用和兼容适配水平。 2025年4月 国家新闻出版署等部门 网络出版科技创新引领计划 健全相关法律法规，保障网络出版企业依法平等享受各项支持政策，加强涉人工智能、游戏引擎、虚拟现实、芯片等网络出版领域知识产权保护，维护创新主体合法权益，激发创新活力。

资料来源：观研天下整理

各省市AI芯片行业相关政策

我国各省市也积极响应国家政策规划,对各省市AI芯片行业的发展做出了具体规划,支持当地AI芯片行业稳定发展，比如2026年8月北京市发布《“AI4Chip”人工智能赋能集成电路产业跨越式发展行动计划（2026—2028年）》，在“AI+智能设计”焕芯方面，涉及AI芯片前沿架构攻关、设计全流程AI赋能、芯片全生命周期管理、芯片设计与制造封测智能化协同、智能体芯片设计助手构建等方面。

我国部分省市AI芯片行业相关政策（一）

省市

发布时间

政策名称

主要内容

北京市

2026年8月

“AI4Chip”人工智能赋能集成电路产业跨越式发展行动计划（2026—2028年）

在“AI+智能设计”焕芯方面，涉及AI芯片前沿架构攻关、设计全流程AI赋能、芯片全生命周期管理、芯片设计与制造封测智能化协同、智能体芯片设计助手构建等方面。

2025年8月

中关村科学城加快建设具有全球影响力人工智能产业高地的若干措施

支持建设国家级人工智能芯片评测平台、大模型评测平台、软硬件适配验证平台、标准公共服务平台、安全伦理平台等，持续建立完善公平、高效、多维的技术服务体系。
2025年7月
北京市加快人工智能赋能科学研究高质量发展行动计划（2025-2027年）
研究面向分子动力学、密度泛函等计算方法下的软硬件协同设计方案，组织研制针对大规模并行计算、高精度等需求的专用计算芯片。
天津市
2025年5月
天津市促进人工智能创新发展行动方案（2025—2027年）
建设高性能智能芯片研发平台，支持中央处理器（CPU）、GPU等核心芯片研发与迭代。支持可重构及存算一体、开源指令集（RISC－V）架构、边缘计算等芯片和高速通信网卡研发。
河北省
2025年3月
石家庄都市圈发展规划
大力发展数字经济核心产业，加快布局半导体外延、芯片设计制造、陶瓷封装、微波器件、卫星导航、应急通信、激光雷达等产业，打造半导体、网络通信、汽车电子三大全产业链。
内蒙古自治区
2026年3月
内蒙古自治区“人工智能+”行动实施方案（2026—2028年）
“人工智能+”开放合作。拓展开放合作新空间。区域协同方向，深化与京津冀、长三角、大湾区等地区的产业对接和协同创新，构建常态化、多层级合作机制，推动人工智能技术、人才、数据等要素流动。
辽宁省
2024年9月
关于科技引领未来产业创新发展的实施意见
聚焦通用人工智能领域，突破智能芯片、科学智能、群体智能、生成式人工智能等关键技术，研发人工智能芯片、垂直领域大模型等产品。
吉林省
2025年9月
吉林省人民政府关于加快推进人工智能创新发展的实施意见
实施“算力联盟”计划，支持基础电信运营商、IDC（互联网数据中心）企业、云服务商等专业化力量建设智算中心，推动智算中心加强国产芯片部署，提升绿电消费比例。
黑龙江省
2026年2月

黑龙江省支持人工智能创新发展若干政策措施
在“人工智能+”低空经济领域，明确鼓励联合飞机、广联航空等企业使用国产人工智能芯片，提高无人机智能感知、决策、控制等能力。
上海市
2025年12月
上海市支持先进制造业转型升级三年行动方案（2026—2028年）
聚焦创新药物及高端制剂、高端医疗器械、合成生物技术、细胞与基因治疗等领域，支持企业发展壮大。深化全栈创新，推动高性能智算芯片加快发展。
2025年8月
上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案
推动电子自动化设计（EDA）企业构建智能化设计能力，缩短设计周期，提升芯片性能。围绕芯片制造、封装等环节，推动人工智能技术在计算光刻、辅助缺陷检测、工艺开发等场景中的应用，提升良率和生产效率。
2025年7月
上海市具身智能产业发展实施方案
发挥上海自主智算芯片、本体机器人与大模型企业集聚优势，加快具身智能专用芯片、核心主板等核心零部件研制，增强软硬协同适配能力，开发匹配具身机器人本体需求的关键配套产品。
2025年7月
上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施
开展关键技术创新。支持人工智能基础理论、方法和工具、新一代通用人工智能、智能芯片、具身智能、智能软件、脑机接口、智算系统等重点前沿方向的技术创新，按照核定项目总投资给予最高30%、最高5000万元支持。
2025年3月
上海市促进检验检测认证行业高质量发展行动方案（2025—2027年）
支持开展人工智能识别感知芯片、车规级芯片、传感器芯片、高密度集成电路封装技术等新产品、新工艺检测技术研究。
江苏省
2025年12月
关于加快人工智能终端产业发展的实施意见
人工智能手机。加快突破高端系统级芯片（SoC）及基带芯片关键核心技术，推动端侧人工智能交互、嵌入式SIM卡（eSIM）等规模化应用，优化提升手机端个人助理、影像优化、行程规划等方面使用体验，提升多模态交互、意图理解与决策、任务编排与跨应用调度等能力，支持智能手机与其他智能终端融合使用。
浙江省

2026年1月

浙江省“十五五”新型工业化规划

大力发展人工智能产业，实施人工智能终端产业发展行动计划，加快构建芯片、大模型、智能体、智能终端、应用服务等全产业链协同发展格局。开展“平台+产业”双向赋能行动，推进平台经济创新和健康发展。

2025年4月

关于支持人工智能创新发展若干措施的通知

加快构建以杭州市、宁波市为核心，其他地区特色化差异化发展，覆盖芯片、服务器、光电网络、系统软件、云平台、大模型、智能终端等全产业链的人工智能发展格局，在人工智能领域争创国家先进制造业集群、未来产业先导区。

安徽省

2026年4月

安徽省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要

围绕核心芯片与器件、软件与算法、网络建设与平台服务、网络运营与应用服务等方向，培育一批创新型中小企业和专精特新企业，开展6G关键架构领域技术攻关，探索开展卫星互联、智能驾驶、无人机群组网作业、沉浸式全息交互等前沿场景应用验证。

2025年5月

关于支持人工智能创新发展若干措施的通知

强化“芯模联动”发展。建设“芯模联动”适配基地，鼓励省内算力龙头企业主动适配大模型训练、推理需求，加快提升芯片性能和万卡级集群组网能力，培育形成具有竞争力的国产算力生态。倡导政府部门、算力中心、经营主体采购或应用国产软硬件。

福建省

2026年1月

“人工智能+制造”专项行动实施意见

强化人工智能算力供给。推动智能芯片软硬协同发展，支持突破高端训练芯片、端侧推理芯片、人工智能服务器、高速互联、智算云操作系统等关键技术。有序推进高水平智算设施布局，加快建设全国一体化算力网监测调度平台，促进算力资源高效利用。开展智算云服务试点，推动大模型一体机、边缘计算服务器、工业云算力部署，提升智算资源供给能力。

江西省

2025年12月

关于融入全国一体化算力网推进全省算力高质量发展的若干措施

发展先进计算产业。依托我省电子信息制造基础，积极引进芯片、关键零部件、整机制造、数据库等企业落地落户。支持有条件的设区市建设数据标注产业基地，加快行业高质量数据集建设，支撑人工智能发展。

山东省

2025年12月
山东省人工智能产业高质量发展行动计划（2025—2027年）
聚力做优“大算力”产业。聚焦人工智能发展核心支撑，优化“智算设备-智算网络-云边协同”算力产业布局。加快研发国产AI芯片服务器等智能算力单元，满足大模型训练、微调、推演等多场景算力需求。
2025年5月
关于支持人工智能全产业链创新发展的若干政策措施
聚焦夯实人工智能基础底座，支持人工智能芯片和软件研发推广应用，每年遴选10家左右集成电路企业，按规定每个给予最高200万元补助；对人工智能软件项目符合省级工业软件研发推广项目要求的，按规定每个给予最高300万元奖励。
河南省
2025年9月
河南省加快人工智能赋能新型工业化行动方案（2025—2027年）
突破人工智能终端。加快高端芯片研发，做强人工智能手机、个人计算机、大模型一体机等整机。围绕智慧城市、智慧教育、智慧环保、智慧交通、智慧医疗等领域需求，发展智能传感器、集成电路等高端元器件和人工智能视听终端、医养终端、车载终端、工业级人工智能终端，支持终端产品与大模型融合创新，探索全新产品形态。 资料来源：观研天下整理

我国部分省市AI芯片行业相关政策（二）
省市
发布时间
政策名称
主要内容
湖北省
2026年4月
湖北省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要
突破新型存储芯片、深度学习通用芯片、自动驾驶芯片、智能传感器、系统软件等关键技术，加快建设存储全产业链集聚区、存储器产业创新街区，打造全链条布局、全品系覆盖的存算一体产业生态。
湖南省
2025年12月
长沙市加快人工智能产业高质量发展若干政策
加大人工智能技术研发，重点支持智能芯片、智能传感器、智算超算系统、智能软件、脑机接口、具身智能、类脑智能、群体智能、智能建造、智能标注、数据合成等领域的技术攻关和探索，鼓励企业、高校、科研机构合作，对国家人工智能揭榜挂帅优胜单位，给予最高20

0万元奖励。
2025年2月
湖南省促进绿色智能计算产业高质量发展若干政策措施
充分发挥制造业“揭榜挂帅”机制作用，加大绿色智能计算核心芯片器件供给，加大高性能、低功耗的端侧芯片开发生产，推进通信、显示、音频等模组研发，探索存算一体、类脑计算、芯粒、指令集等芯片研发与应用，培育高端芯片创新发展生态。
广东省
2026年3月
广东省加快培育发展新赛道引领现代化产业体系建设行动规划（2026—2035年）
加快推动自动驾驶核心算法、算力芯片和传感元件等关键核心技术攻关，强化感知、决策、通信等关键环节创新能力，持续提升L2级辅助驾驶能力，加快发展L3、L4等高阶自动驾驶，并部署建设若干全场景全域无人交通试验“安全沙箱”，开展全系统应用验证。
2025年11月
关于印发广东省国家数字经济创新发展试验区建设方案（2025—2027年）的通知
建设适配芯片的开发生态，加快高性能、低功耗端侧芯片研发生产与验证应用。鼓励企业通过集成算力芯片、处理器、射频通信、智能传感器、光芯片、存储器等，推进决策、控制、驱动、通信、显示等模组研发。
2025年8月
广东省加快扩大工业有效投资实施方案（2025—2027年）
加力推动电子信息、石化化工、家电、汽车、机械、材料、轻工纺织、食品饮料等产业强链补链延链稳链，加快推进“广东强芯”、汽车芯片应用牵引等重大工程，深入实施“百链韧性提升”专项行动，引进建设一批产业粘性大、市场前景好、技术先进、绿色低碳的优质项目，进一步提升投资能级。
2025年4月
广东省关于进一步深化投融资体制改革的若干举措
在投入大、专业性强且社会力量相对缺位的低空经济、生物制造、光芯片等领域，由政府支持建设一批中试平台，畅通科技成果产业化的通道。
2025年2月
广东省建设现代化产业体系2025年行动计划
加快华润微、方正微、粤芯、增芯等重大项目建设和产能“爬坡”，补齐集成电路制造、先进封测等短板，大力发展材料及装备产业，谋划建设光芯片产业创新平台，打造全国集成电路“第三极”。
广西壮族自治区
2025年8月
广西制造业重点优势产业补链强链延链行动方案

重点引进“三电”系统、动力总成、智能网联核心零部件等环节，突破固态电池、车用芯片和操作系统等关键技术，增强铸造生铁、铝轮毂、铝车身等产品配套能力。
海南省
2025年8月
海南省加快构建具有特色和优势现代化产业体系三年行动方案（2025-2027年）
基于区块链、AI、大数据技术推动数字健康、数字文娱、共享平台等业态提升能级，积极布局游戏出海、来数加工、半导体芯片、集成电路等产业。
重庆市
2025年3月
重庆市打造民营经济发展高地若干措施
提高民营企业在“卡脖子”领域牵头承担和实施重大（重点）研发项目比例，按规定对民间资本参与的市级科技创新重大研发项目给予1000万—3000万元的支持，对首次获评国家级专精特新“小巨人”民营企业、制造业单项冠军民营企业给予奖励，对牵头承担核心软件、高端器件与芯片、先进制造等重点领域项目的民营企业给予资金支持。
2025年1月
重庆市推动经济持续向上向好若干政策举措
支持科技领军企业、产业链龙头企业等牵头承担的人工智能、核心软件、高端器件与芯片、先进制造、生物医药等重大重点科技专项，对单个项目给予资金支持。
四川省
2025年9月
四川智慧农业行动计划（2025—2028年）
提升“天府良机”装备科研、制造、服务能力，加大农业领域传感器、芯片、算法、模型等攻关，支持农业机器人、智慧灌溉等领域高端智能农机装备研发。
贵州省
2025年8月
贵州省低空经济高质量发展三年行动方案（2025—2027年）
用好通信网络5G、大数据、低空通信感知、高精度导航等先进技术，集聚飞控系统、航电系统、主控芯片、精密元器件、核心传感器、机载态势感知等装备制造企业，培育发展通信、导航等低空飞行数智软件研发产业。
云南省
2025年8月
云南省支持低空经济健康发展的若干措施
支持高原无人机免费测试。支持建设高原无人机试验基地，形成高原无人机电池、电机、芯片、飞行控制系统、智能导航、机身材料等全体系、全链条试验测试能力。
陕西省

2026年4月
西安市促进半导体及光子产业高质量发展实施方案
支持设计业拓源壮大。鼓励高校、科研院所进行成果转化，从而“衍生”公司。围绕存储芯片、功率芯片、通信芯片、光电芯片等优势领域，支持一批设计企业及分公司（研发中心）扩大布局，做大做强。
甘肃省
2026年1月
“人工智能+制造”专项行动实施意见
发挥工业和信息化部人工智能标委会、全国数据标准化委员会、全国信标委人工智能分委会、全国集成电路标委会人工智能芯片工作组、全国网安标委新技术安全标准特别工作组作用，加强标准技术组织建设。
青海省
2026年8月
青海省绿色算力产业发展“十五五”规划
开展集成电路用电子级多晶硅等半导体关键原材料的研发创新，探索在青布局大尺寸硅片、碳化硅晶片、半导体晶圆及外延片产业化项目，攻坚光纤光棒材料制备、无源光芯片制作等高端技术，发展光纤预制棒、光纤拉丝等产品。依托电解铝产业基础，向上游元器件关键材料领域延伸布局，发展氧化铝抛光液、透明陶瓷用高纯氧化铝粉等芯片用高端精细氧化铝产品，推动纳米级陶瓷粉体、微波陶瓷粉体等元器件关键材料研发及产业化。
资料来源：观研天下整理（xyl）
注：上述信息仅作参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。
更多图表和内容详见报告正文。
·关于行业报告
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势、洞悉行业竞争格局、规避经营和投资风险的必备工具，本报告是全面了解本行业、制定正确竞争战略和投资决策的重要依据。
·报告内容涵盖
观研报告网发布的《中国AI芯片行业发展现状研究与投资前景预测报告（2026-2033年）》数据丰富，内容详实，整体图表数量达到130个以上，涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容，帮助业内企业准确把握行业发展态势、市场商机动向，正确制定企业竞争战略和投资策略。
·报告数据来源
报告数据来源包括：国家统计局、海关总署等国家统计部门；行业协会、研究院所等业内权威机构；各方合作数据库以及观研天下自有的数据中心；以及对业内专家访谈调研的一手数

据信息等。
我们的数据已被官方媒体、证券机构、上市公司、高校部门等多方认可并广泛引用。（如需数据引用案例请联系观研天下客服索取）
报告主要图表介绍
图（部分）
表（部分）
2021-2025年行业市场规模
行业相关政策
2021-2025年行业产量
行业相关标准
2021-2025年行业销量
PEST模型分析结论
2025年行业成本结构情况
行业所属行业企业数量分析
2021-2025年行业平均价格走势
行业所属行业资产规模分析
2021-2025年行业毛利率走势
行业所属行业流动资产分析
2021-2025年行业细分市场1市场规模
行业所属行业销售规模分析
2026-2033年行业细分市场1市场规模及增速预测
行业所属行业负债规模分析
2021-2025年行业细分市场2市场规模
行业所属行业利润规模分析
2026-2033年行业细分市场2市场规模及增速预测
所属行业产值分析
2021-2025年全球行业市场规模
所属行业盈利能力分析
2025年全球行业区域市场规模分布
所属行业偿债能力分析
2021-2025年亚洲行业市场规模
所属行业营运能力分析
2026-2033年亚洲行业市场规模预测
所属行业发展能力分析
2021-2025年北美行业市场规模

企业1营业收入构成情况
2026-2033年北美行业市场规模预测
企业1主要经济指标分析
2021-2025年欧洲行业市场规模
企业1盈利能力分析
2026-2033年欧洲行业市场规模预测
企业1偿债能力分析
2026-2033年全球行业市场规模分布预测
企业1运营能力分析
2026-2033年全球行业市场规模预测
企业1成长能力分析
2025年行业区域市场规模占比
企业2营业收入构成情况
2021-2025年华东地区行业市场规模
企业2主要经济指标分析
2026-2033年华东地区行业市场规模预测
企业2盈利能力分析
2021-2025年华中地区行业市场规模
企业2偿债能力分析
2026-2033年华中地区行业市场规模预测
企业2运营能力分析
2021-2025年华南地区行业市场规模
企业2成长能力分析
2026-2033年华南地区行业市场规模预测
企业3营业收入构成情况
2021-2025年华北地区行业市场规模
企业3主要经济指标分析
2026-2033年华北地区行业市场规模预测
企业3盈利能力分析
2021-2025年东北地区行业市场规模
企业3偿债能力分析
2026-2033年东北地区行业市场规模预测
企业3运营能力分析
2021-2025年西南地区行业市场规模
企业3成长能力分析

2026-2033年西南地区行业市场规模预测
企业4营业收入构成情况
2021-2025年西北地区行业市场规模
企业4主要经济指标分析
2026-2033年西北地区行业市场规模预测
企业4盈利能力分析
2026-2033年行业市场分布预测
企业4偿债能力分析
2026-2033年行业投资增速预测
企业4运营能力分析
2026-2033年行业市场规模及增速预测
企业4成长能力分析
2026-2033年行业产值规模及增速预测
企业5营业收入构成情况
2026-2033年行业成本走势预测
企业5主要经济指标分析
2026-2033年行业平均价格走势预测
企业5盈利能力分析
2026-2033年行业毛利率走势
企业5偿债能力分析
行业所属生命周期
企业5运营能力分析
行业SWOT分析
企业5成长能力分析
行业产业链图
企业6营业收入构成情况
……
……
图表数量合计
130+

· 关于我们

观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队以及十四年的数据累积资源，研究领域覆盖到各大小细分行业，已经为上万家企业单位、政府部门、咨询机构、金融机构、行业协会、高等院校、行业投资者等提供了专业的报告及定制报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广

泛认可。

目录大纲：

【第一部分 行业基本情况与监管】
第一章 AI芯片
第一节 AI芯片
一、AI芯片
二、AI芯片
三、AI芯片
四、AI芯片
1、生产模式
2、采购模式
3、销售/服务模式
第二节 中国 AI芯片
第三节 中国 AI芯片
第二章 中国 AI芯片
第一节 中国 AI芯片
一、行业主要监管体制
二、行业准入制度
第二节 中国 AI芯片
一、行业主要政策法规
二、主要行业标准分析
第三节 国内监管与政策对 AI芯片
【第二部分 行业环境与全球市场】
第三章中国 AI芯片
第一节 中国宏观经济发展现状
第二节 中国对外贸易环境与影响分析
第三节 中国 AI芯片
一、PEST模型概述
二、政策环境影响分析
三、 经济环境影响分析
四、社会环境影响分析
五、技术环境影响分析
第四节 中国 AI芯片

第四章 全球AI芯片
第一节 全球AI芯片
第二节 全球AI芯片
一、2021-2025年全球AI芯片
二、全球AI芯片
第三节 亚洲AI芯片
一、亚洲AI芯片
二、2021-2025年亚洲AI芯片
三、亚洲AI芯片
第四节 北美AI芯片
一、北美AI芯片
二、2021-2025年北美AI芯片
三、北美AI芯片
第五节 欧洲AI芯片
一、欧洲AI芯片
二、2021-2025年欧洲AI芯片
三、欧洲AI芯片
第六节 2026-2033年全球AI芯片
第七节 2026-2033年全球AI芯片
【第三部分 国内现状与企业案例】
第五章 中国AI芯片
第一节 中国AI芯片
一、AI芯片行
二、AI芯片行
第二节 中国AI芯片
一、影响中国AI芯片
二、2021-2025年中国AI芯片
三、中国AI芯片
第三节 中国AI芯片
一、2021-2025年中国AI芯片
二、中国AI芯片
第四节 中国AI芯片
一、2021-2025年中国AI芯片
二、中国AI芯片
第五节 中国AI芯片

第六章 中国AI芯片
第一节 中国AI芯片
第二节AI芯片
一、AI芯片行
二、AI芯片行
三、2021-2025年中国AI芯片
第三节AI芯片
一、AI芯片
二、AI芯片
第四节 中国AI芯片
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第五节 中国AI芯片
第七章 中国AI芯片
第一节 中国AI芯片
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、AI芯片
第二节 中国AI芯片
一、上游产业发展现状
二、上游产业对AI芯片
三、下游产业发展现状
四、下游产业对AI芯片
第三节 中国AI芯片
一、中国AI芯片
二、细分市场分析——市场1
1、2021-2025年市场规模与现状分析
2、2026-2033年市场规模与增速预测
三、细分市场分析——市场2
1、2021-2025年市场规模与现状分析
2、2026-2033年市场规模与增速预测
（细分市场划分详情请咨询观研天下客服）
第八章 中国AI芯片

第一节 中国AI芯片
一、中国AI芯片
二、中国AI芯片
第二节 中国AI芯片
一、中国AI芯片
二、中国AI芯片
第三节 中国AI芯片
一、企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第四节 中国AI芯片
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第九章 中国AI芯片
第一节 中国AI芯片
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国AI芯片
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国AI芯片
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十章 中国AI芯片
第一节 中国AI芯片

一、影响 | | | | | | AI芯片 | | | | | |

2、东北地区 AI芯片
3、2026-2033年东北地区 AI芯片
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区 AI芯片
1、2021-2025年西南地区 AI芯片
2、西南地区 AI芯片
3、2026-2033年西南地区 AI芯片
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区 AI芯片
1、2021-2025年西北地区 AI芯片
2、西北地区 AI芯片
3、2026-2033年西北地区 AI芯片
第九节 2026-2033年中国 AI芯片
第十一章 AI芯片
第一节 企业1
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优势分析
第二节 企业2
第三节 企业3
第四节 企业4
第五节 企业5
第六节 企业6
第七节 企业7
第八节 企业8

第九节 企业9
第十节 企业10
【第四部分 行业趋势、总结与策略】
第十二章 中国AI芯片
第一节 中国AI芯片
第二节 2026-2033年中国AI芯片
第三节 2026-2033年中国AI芯片
一、2026-2033年中国AI芯片
二、2026-2033年中国AI芯片
三、2026-2033年中国AI芯片
第四节 2026-2033年中国AI芯片
一、2026-2033年中国AI芯片
二、2026-2033年中国AI芯片
第五节 2026-2033年中国AI芯片
第六节 2026-2033年中国AI芯片
第十三章 中国AI芯片
第一节 观研天下中国AI芯片
一、未来AI芯片
二、未来AI芯片
第二节 中国AI芯片
第三节 中国AI芯片
一、SWOT模型概述
二、行业优势
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国AI芯片
第四节 中国AI芯片
第五节 中国AI芯片
第六节 观研天下中国AI芯片
第十四章 中国AI芯片
第一节 中国AI芯片
一、目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择

第二节 中国AI芯片
一、AI芯片
二、AI芯片
三、AI芯片
四、AI芯片
五、AI芯片
第三节AI芯片
一、AI芯片
二、AI芯片
三、AI芯片
四、AI芯片
第四节 观研天下分析师投资建议

详细请访问：https://www.chinabaogao.com/baogao/202609/818278.html